

# 要約

ダイパッドと、半導体チップと、封止樹脂とを備える半導体装置およびその製造方法が提供される。ダイパッドは、第1の面およびこれと反対の第2の面を有し、当該第2の面は露出部と当該露出部の周りの退避部とを有する。半導体チップは、ダイパッドの第1の面に搭載されている。封止樹脂は、ダイパッドの露出部を露出させつつ退避部に接してダイパッドおよび半導体チップを覆う。

applied in the number **EL 913562208US**

**OCTOBER 17, 2001**  
The following was deposited  
with the U.S. Patent Office "Diamond Mail" box  
on October 17, 2001, in the name of ST MICROELECTRONICS, INC.  
and is addressed to the  
Department of Commerce and Trademarks, Washington,  
D.C. 20530

**CHRIS STORDAHL**  
*Chris Stordahl*  
6/10/01